GlobalWafers Co., Ltd.
環球晶圓股份有限公司

2020年4月

環球晶圓
2019年第4季營運報告

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved

Disclaimer

This presentation has been prepared by GlobalWafers Co., Ltd. (the “Company”). This presentation and the materials provided herewith do not constitute an offer to sell or issue or the solicitation of an offer to buy or acquire securities of the Company in any jurisdiction or an inducement to enter into investment activity, nor may it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Any decision to purchase securities in a proposed offering should be made solely on the basis of the information contained in the offering circular published in relation to such proposed offering, if any.

The information contained in this presentation has not been independently verified. No representation, warranty or undertaking, express or implied, is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness or correctness of the information or the opinions contained herein. The information contained in this document should be considered in the context of the circumstances prevailing at the time and has not been, and will not be, updated to reflect material developments which may occur after the date of the presentation. None of the Company nor any of its affiliates, advisors or representatives will be liable (in negligence or otherwise) for any loss howsoever arising from any use of this presentation or its contents or otherwise arising in connection with the presentation.

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved

經營團隊重點報告

- 前景展望
  - 新冠肺炎的流行為全球經濟增添許多不確定性。
  - 供應鏈中斷、延遲復工以及越來越多的城市/國家限制進出將暫時影響全球電子供應鏈。
  - 環球晶圓部分生產據點受到影響國家封境政策影響，將謹慎靈活調動全球產能因應。
  - 若新冠肺炎之蔓延未能有效遏止，預期將對全球經濟產生衝擊。
  - 無客戶取消訂單，部分客戶為求庫存的穩定而增加訂單。
  - 持續謹慎監控匯率波動，以確保衝擊降至最小。
  - 雖疫情影響近期發展，然而長遠看來，科技創新仍將驅動成長。

- 2019
  - 突破紀錄的一年
    - ✓ 史上第二高的營業收入：台幣580億(1.6%的年減率)
    - ✓ 許多歷史新高–
      EBITDA百分比、毛利及毛利率、營業淨利及營業淨利率、淨利及淨利率、每股盈餘.....
    - ✓ 每股盈餘為創建以來最高：新台幣31.35元，每股股利：新台幣25元，高配發比率：79.7%
    - ✓ 每六個月配發一次股利。
      (2020年上半年股利將於2021年第一季配發； 2020年下半年股利將於2021年第三季配發)

** 2019年股利配發待2020年6月23日股東會常會決議。*

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved

- 韓國二廠
  - 環球晶圓12吋矽晶圓製造之重要據點 。
  - 環球晶圓成為客戶優先選擇合作的夥伴因具備以下優勢：
    - ✓ 「世界各國」的「多元供應」可做為客戶的緊急應變計畫
    - ✓ 「本地供應」減少總體經濟的不確定性與地緣政治摩擦
    - ✓ 「靈活調配」全球產能可「彈性出貨」
- 境外資金回台
  - 金額：美金3億5千5百萬元 (超過台幣100億元)
  - 投資計劃:
    - ✓ 擴充先進製程
    - ✓ 增加SiC晶圓與半絕緣SiC晶圓之產能
    - ✓ 加強台灣總部之研發、增進產品差異化
    - ✓ 投資綠色能源開發以減少二氧化碳之排放
- 與GLOBALFOUNDRIES簽署MOU，將長期供應12吋SOI晶圓。
- 庫存
  - 2019年下半年半導體產業持續消化庫存，加上第四季的季節性調整，大多數客戶的矽晶圓存貨較上一季略微下降或持平。
  - 科技創新將更進一步帶動2020年的矽晶圓庫存消化。

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved

公司概況 (新冠肺炎前)

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved

Company Overview

➢ 世界首屈一指的矽晶圓製造商，生產據點遍佈全球

營運重點

創立	■ 2011年自中美矽晶分割獨立
領先地位	■ 全世界**第三大**矽晶圓供應商 非日本區域**最大**供應商
營運總部	■ **台灣**新竹科學園區
產品	■ **完整產品組合**、涵蓋3吋至12吋各式晶圓
生產據點	■ 據點遍佈**全球**，歐洲、亞洲、美洲皆有生產基地
員工人數	■ # **6,700** (截至2020年2月底)
研發能量	■ 全球6區域擁有近**1,300**專利

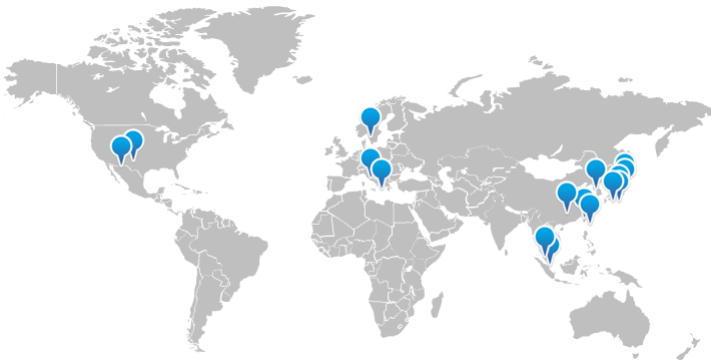
備註:包括已獲證及申請中之專利

世界據點

01 **16** 營運據點位於**9**個國家

02 遍佈全球的營運據點能**即時回應全世界的客戶**

03 **深度整合世界科技與人才**



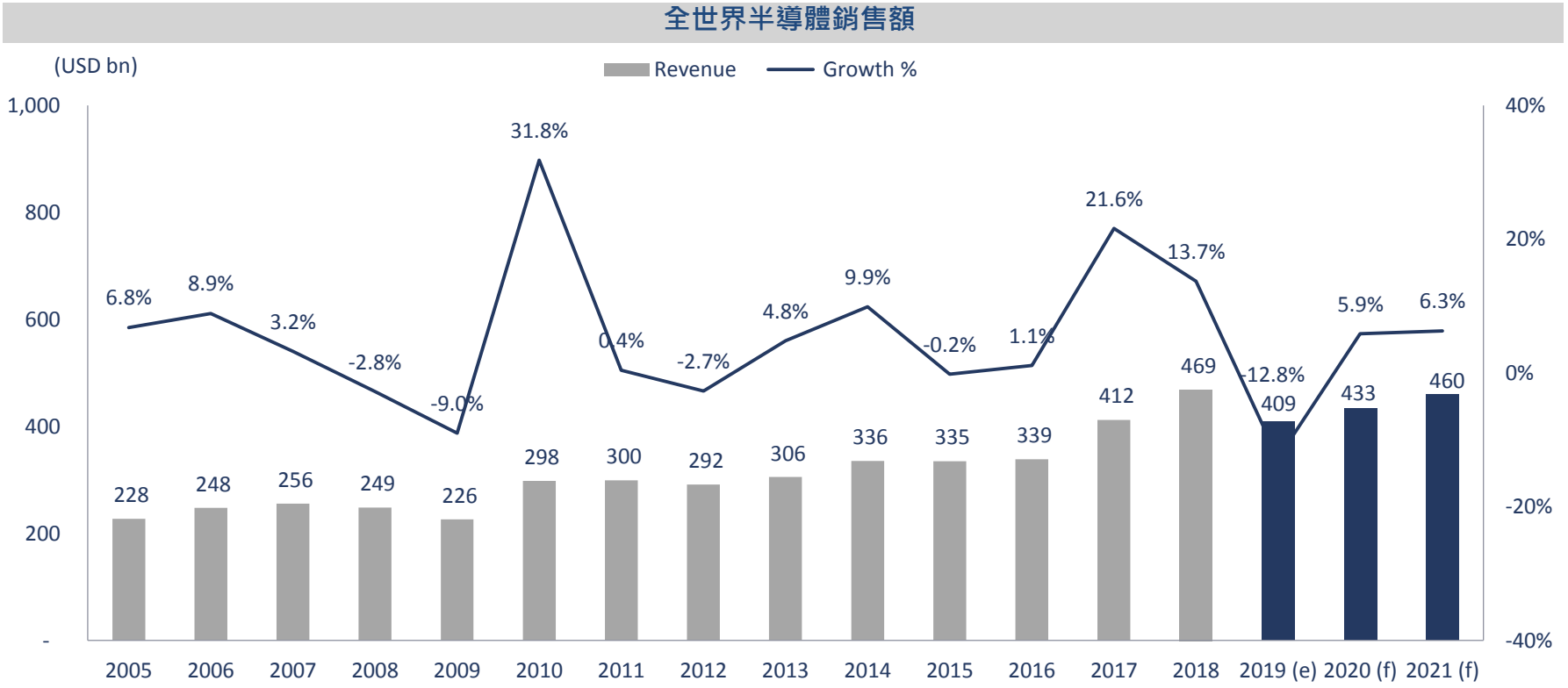
© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved

產業概況(新冠肺炎前)

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved

全世界半導體銷售額

- 創新應用為半導體市場增添成長動能。
- 研調機構預估，2020年全球各區域的半導體市場規模將會恢復成長，平均成長率為5.9%，光電元件和Logic是最大助力。

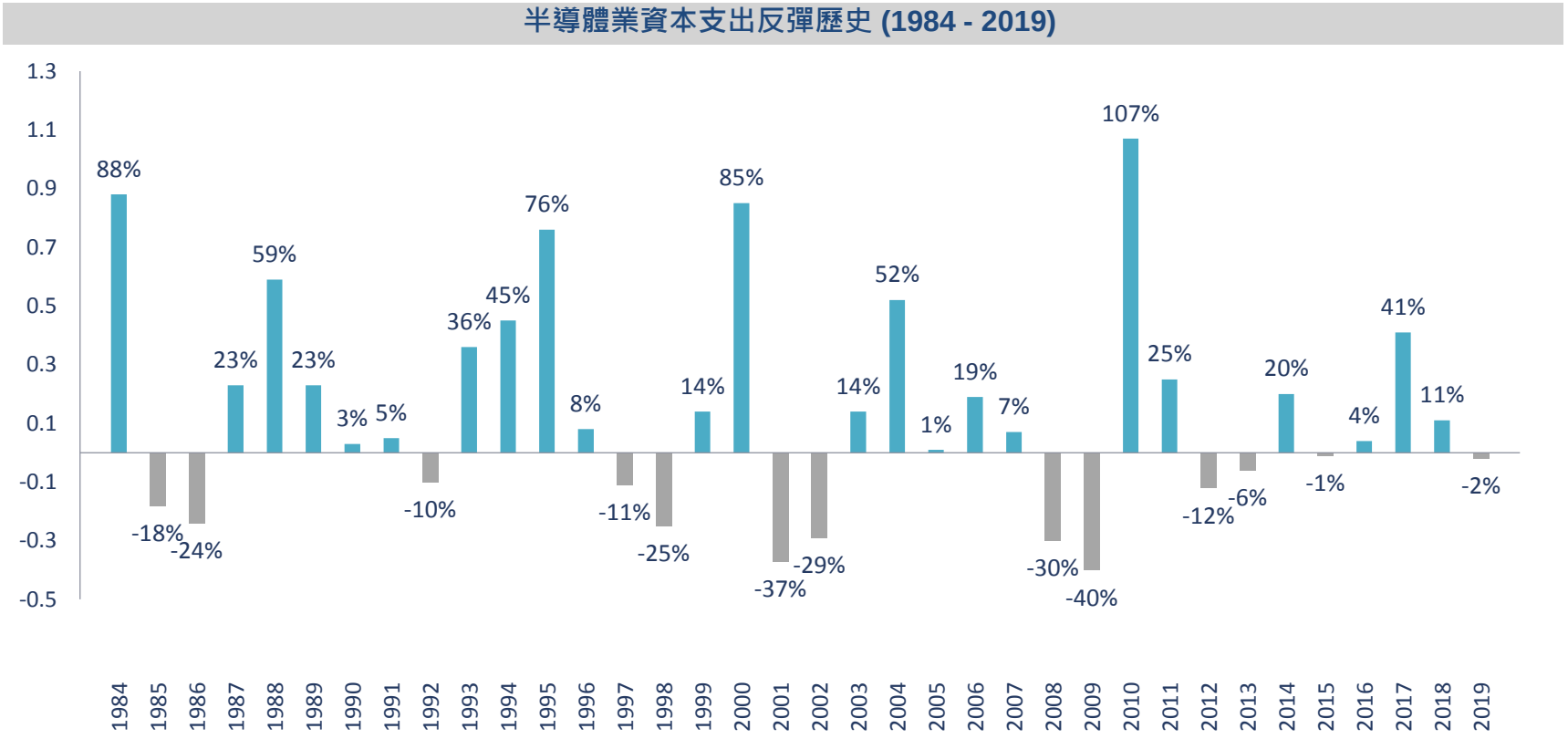


Source : WSTS, December, 2019

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved

半導體業資本支出反彈歷史

- 資本支出與半導體產業景氣具正向連結，可預估近期將好轉。



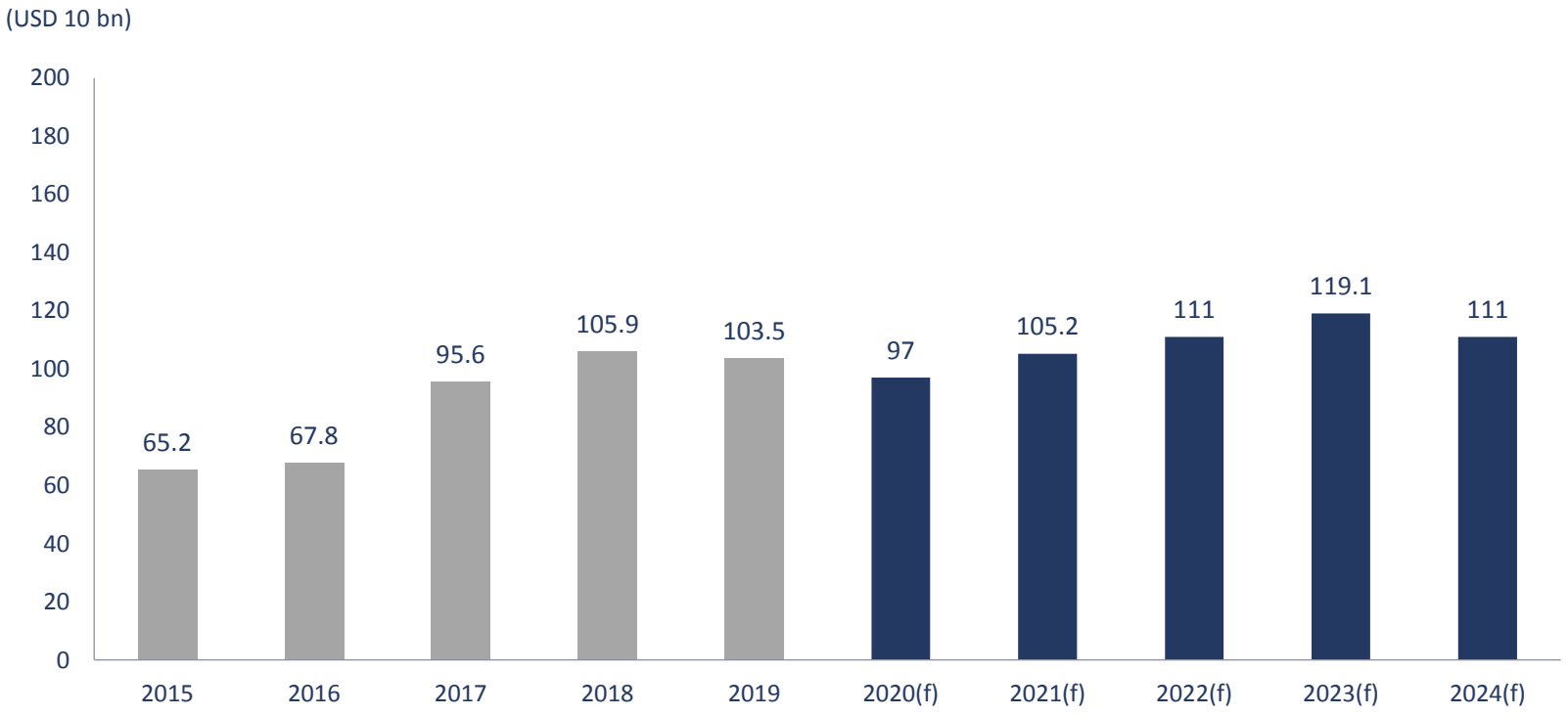
Source: IC Insights, Digitimes, February, 2020

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved

半導體資本支出持續增加

- 半導體製造商持續擴大資本支出以涵蓋日益複雜的終端應用及創新。
- 預計資本支出將在2021年轉為上升，並連續3年保持增長。

半導體業全球資本支出預測

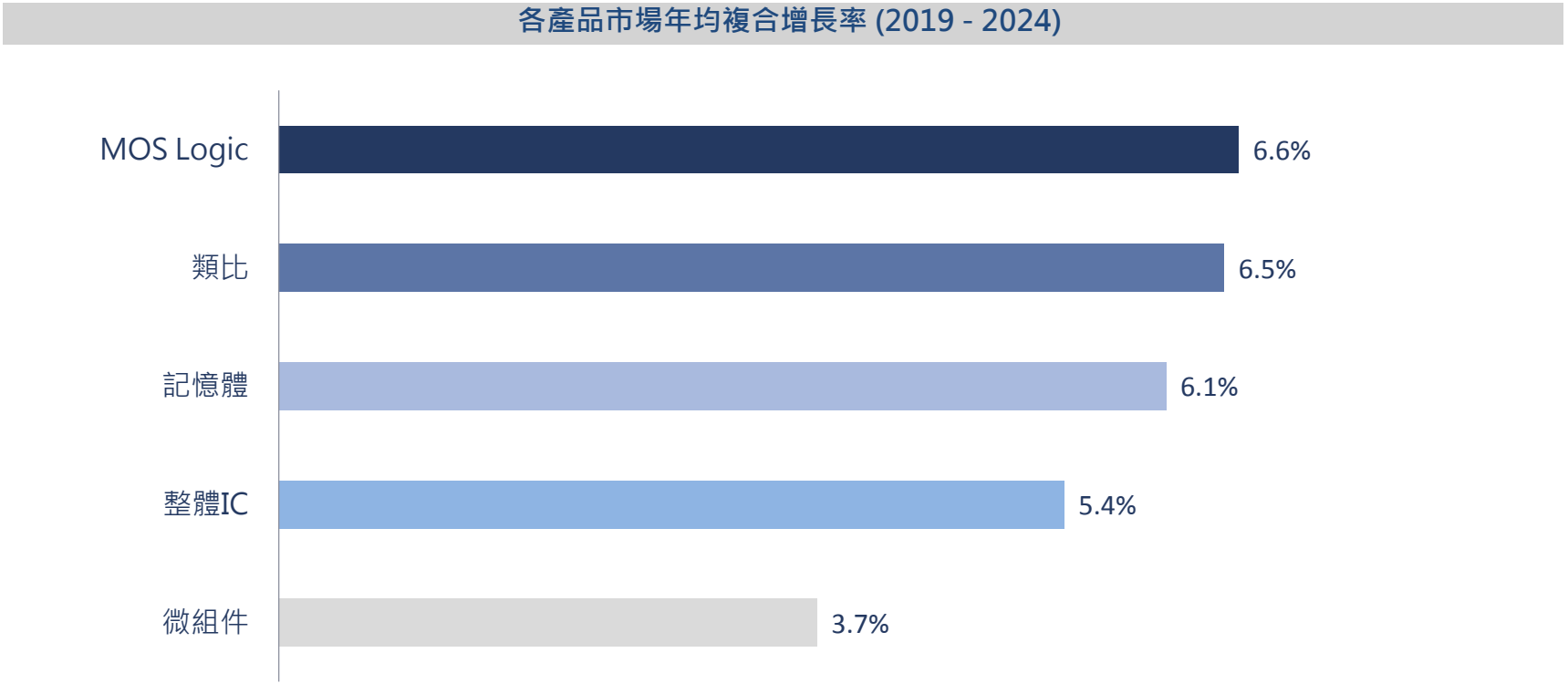


Source: IC Insights, Digitimes, February, 2020

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved

主要產品項目之年均複合增長率

- 消費電子、車用電子和其他領域的持續創新刺激並支撐各個類別的需求與成長。



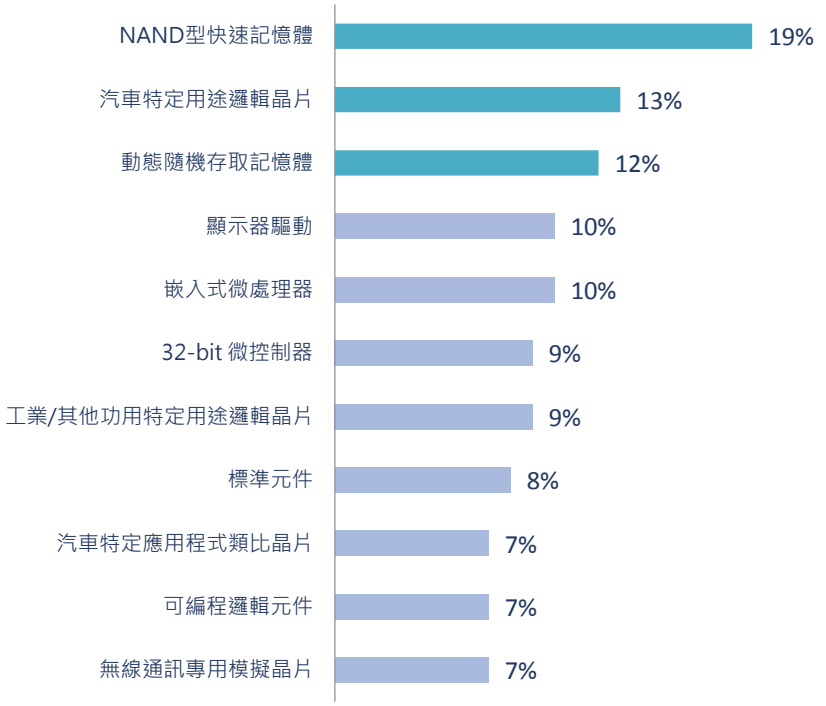
Source: IC Insights, January, 2020

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved

IC 產品的正向成長

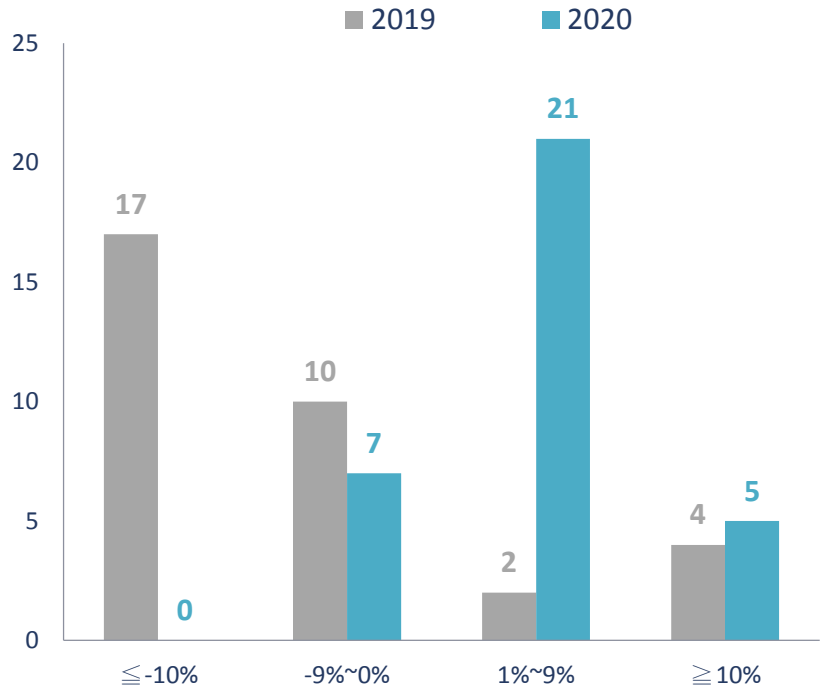
- NAND Flash, Logic 和 DRAM為2020年成長前三大的IC類別。
- 與2019年僅6個IC產品類有正向成長相比，2020年成長強勁，預測共有26項成長，其中5項將呈二位數增加，而2019年僅有4項。

IC 市場成長預估排名(2020)



Source: IC Insights, January, 2020

產品增長率分佈

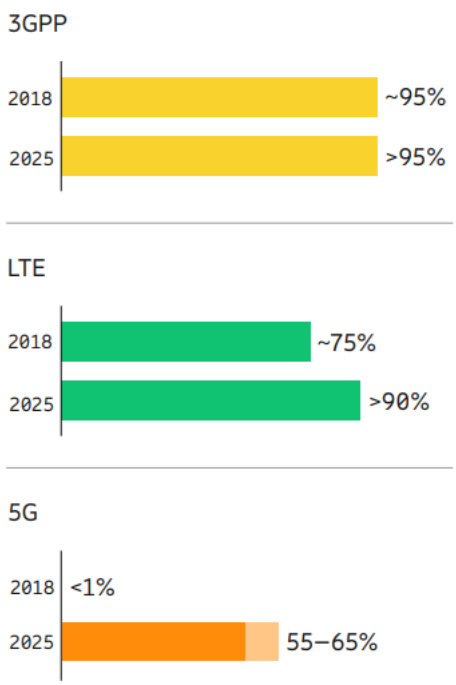


© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved

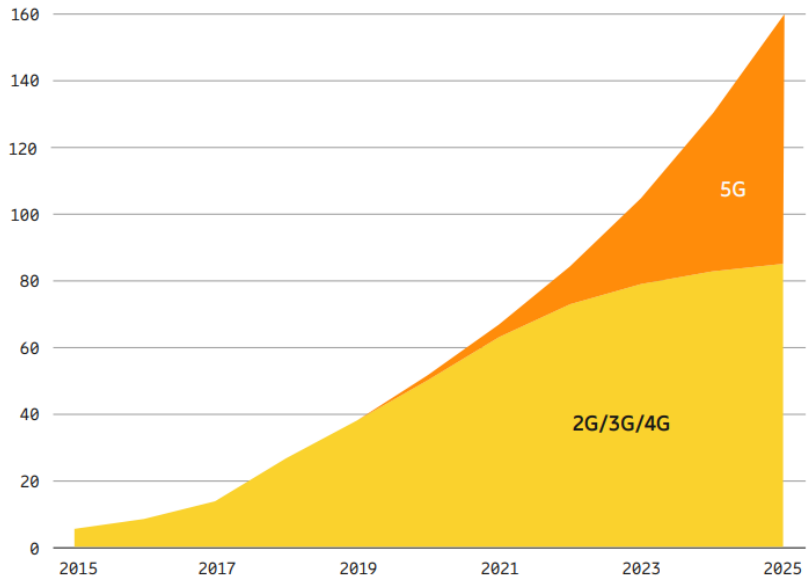
5G 全球覆蓋率

- 科技創新加快5G佈建速度，預估2025年全球65%人口將居住在5G網路涵蓋範圍內。
- 預估至2025年，45%數據傳輸量將透過5G網路進行。
- 5G是有史以來佈建最快的行動通訊科技。

通訊技術與世界人口覆蓋率*1



全球移動數據流量*2 (EB*3 /每月)



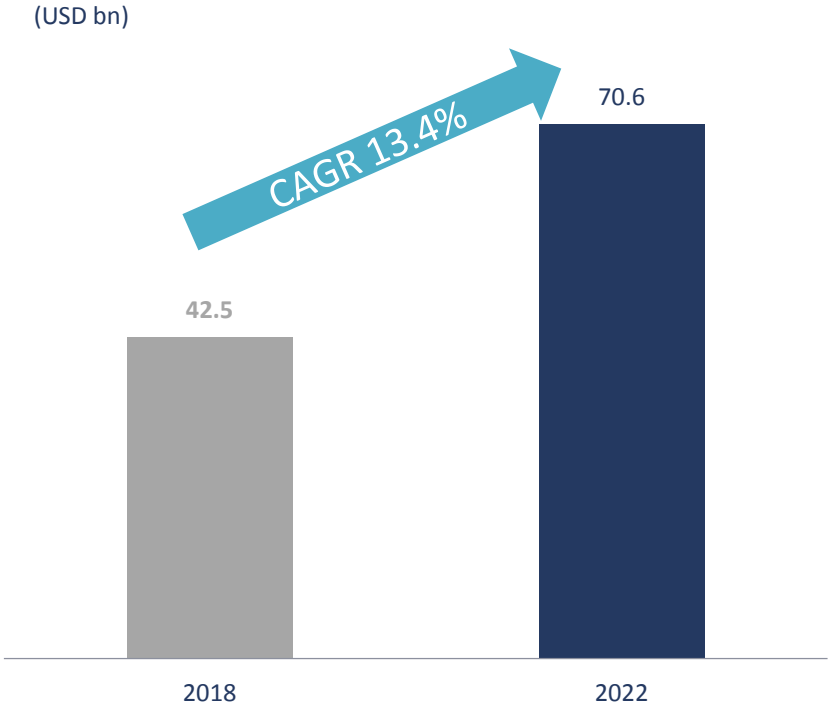
Source: Ericsson Mobility Report. November, 2019.
Note : 1. 以上反映每項技術的覆蓋範圍，而是否能利用該科技將視所使用的配備及方案等因素。
2. 代表超過60億人口在智慧型手機、筆記型電腦等多功能新型工具上所使用的數據流量。
3. EB = Exabyte = 1,024 PB

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved

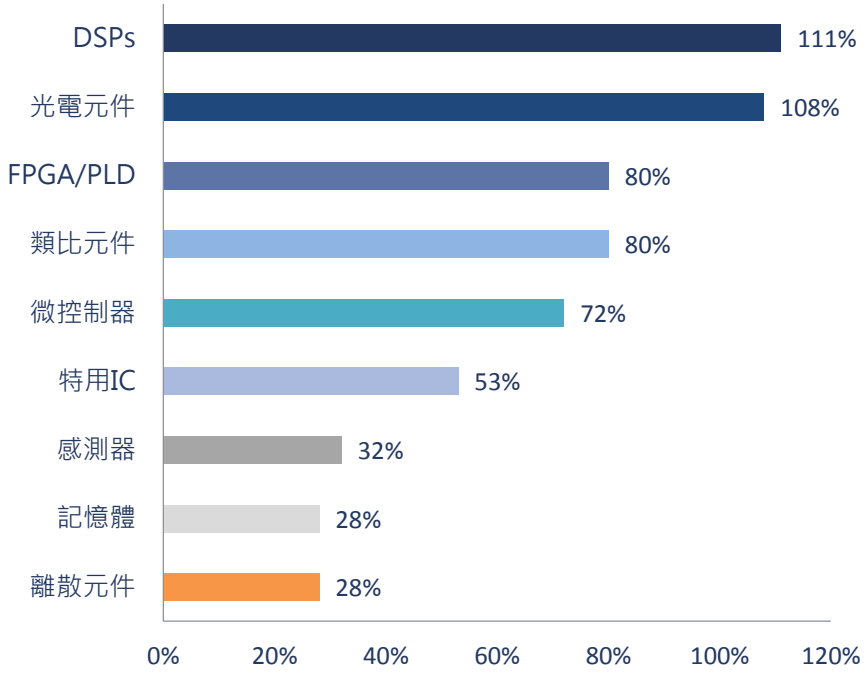
全球車用半導體規模

- 研究機構預估全球車用半導體市場規模將由2018年的425億美元，成長為2022年的706億美元，合計年複合成長率(CAGR)為13.4%。
- 在各類半導體元件中，以應用於車載資訊娛樂系統和音訊設備中的數位訊號處理器(DSPs)，以及應用於ADAS和駕駛監控系統中的光電元件(optoelectronics)銷售額成長最快。

全球車用半導體市場規模



車用半導體元件類別銷售額成長預估 (2018~2022)



Source: IC Insights, January, 2020

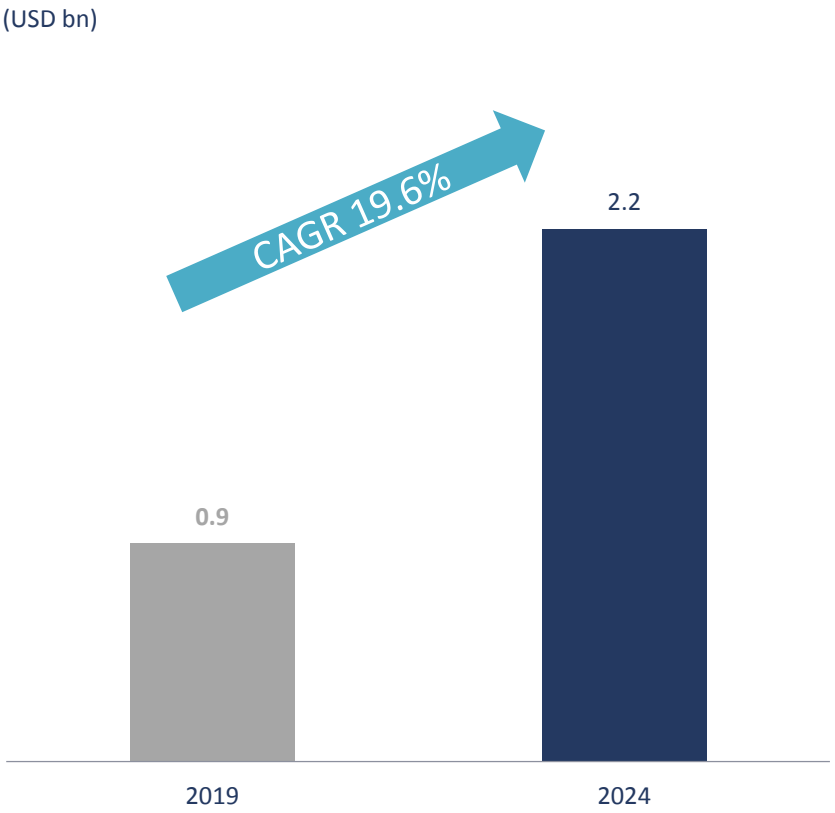
© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved

SOI(Silicon-on-Insulator)市場規模倍增

SOI 市場規模

- SOI (絕緣層上覆矽)具備低電壓運行與高效能表現等特性，比建在傳統CMOS製程(Bulk CMOS)電路的速度快了30%、耗能減少80%，適用於行動裝置。

- 隨5G陸續商轉，推動SOI在通訊(行動裝置、基礎建設)、物聯網(IoT)、汽車電子等相關應用採用情況增加，全球SOI市場規模從2019年的9億美元增加至2024年的22億美元，複合成長率為19.6%。



Source: Markets and Markets, December, 2019

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved

營運表現

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved

2019財務摘要

1. 創歷史新高
   - EBITDA百分比、毛利及毛利率、營業淨利及營業淨利率、淨利及淨利率、每股盈餘.....
   - 顯示環球晶圓的正確營運策略和高超的供應鏈管理效率。

2. 每股盈餘&股利
   - 2019年每股盈餘為台幣31.35元 (史上最高)。
   - 提撥股利-每股新台幣25元*1(配發率79.7%)。
   - 每半年即配發股利。

3. 財務比例
   - 充足現金–新台幣32,822 百萬(相當於美金1,095百萬元) *2 。
   - 預付貨款–新台幣 20,393 百萬 (相當於美金680百萬元)*2 。

備註
1. 2019年股利配發待2020年6月23日股東會常會決議。
2. 匯率 : 台幣:美金=29.98

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved

財務摘要: 2019 vs. 2018

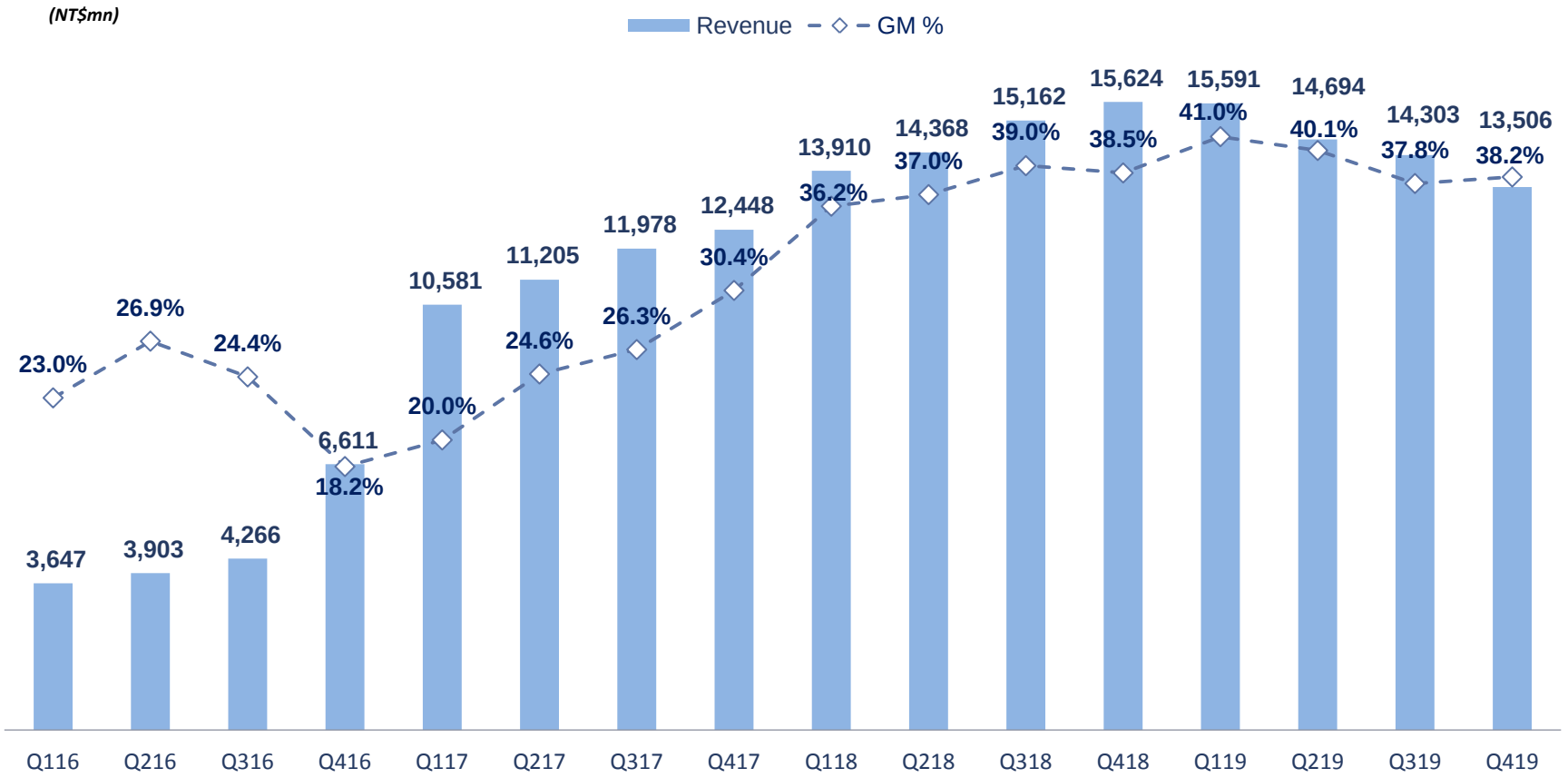
(NT$百萬)	2019	2018	年成長率
營業收入	58,094	59,064	-1.6%
EBITDA*[1]	22,648	22,712	-0.3%
EBITDA (%)	39.0%	38.5%	1.4%
EBIT	17,902	17,897	0.0%
營業淨利	17,897	17,578	1.8%
營業淨利(%)	30.8%	29.8%	1.0%
本期淨利	13,636	13,634	0.0%
本期淨利 (%)	23.5%	23.1%	0.4%
每股盈餘	NT$31.35	NT$31.18	NT$0.17
股東權益報酬率 /ROE*[2] (年化)	30.9%	35.3%	-4.4%
資產報酬率/ROA*[3](年化)	14.7%	17.1%	-2.5%

1.EBITDA=本期淨利+折舊費用+攤銷費用+利息+所得稅
2.ROE = 本期淨利/股東平均權益
3.ROA = ((本期淨利+利息(1-有效稅率))/平均資產*

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved

營業收入 & 毛利

- 保持高水位，全年毛利率為創立以來最佳（39.3%）。



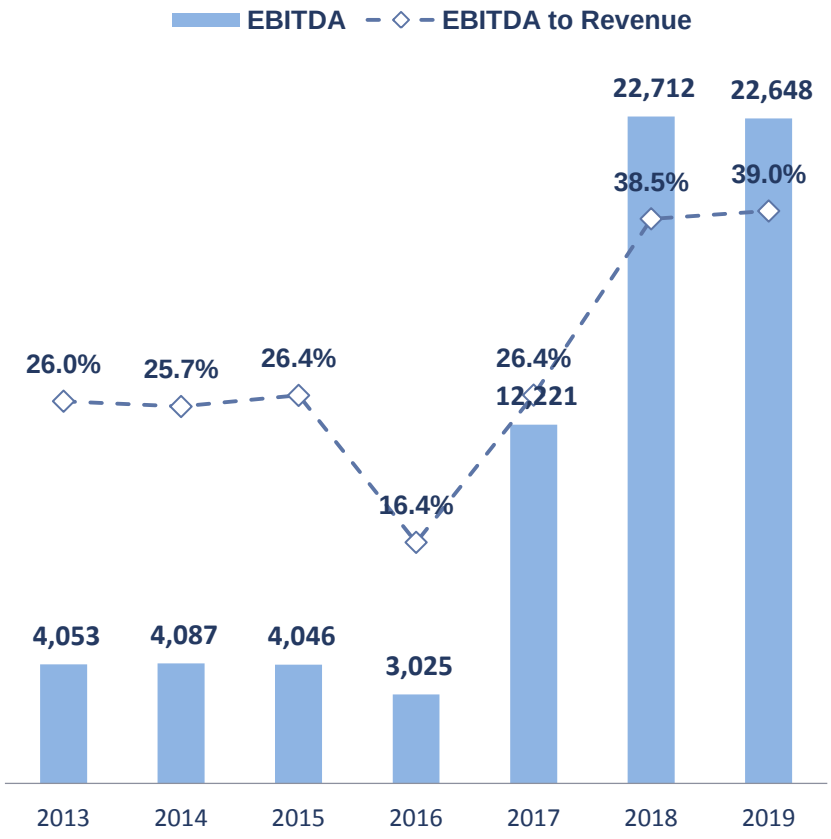
© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved

EBITDA & 每股盈餘

- EBITDA – 雖2019年充滿市場逆風與總體環境不確定性，EBITDA百分比仍創歷史新高。
- 每股盈餘達新台幣31.35元，歷史新高！

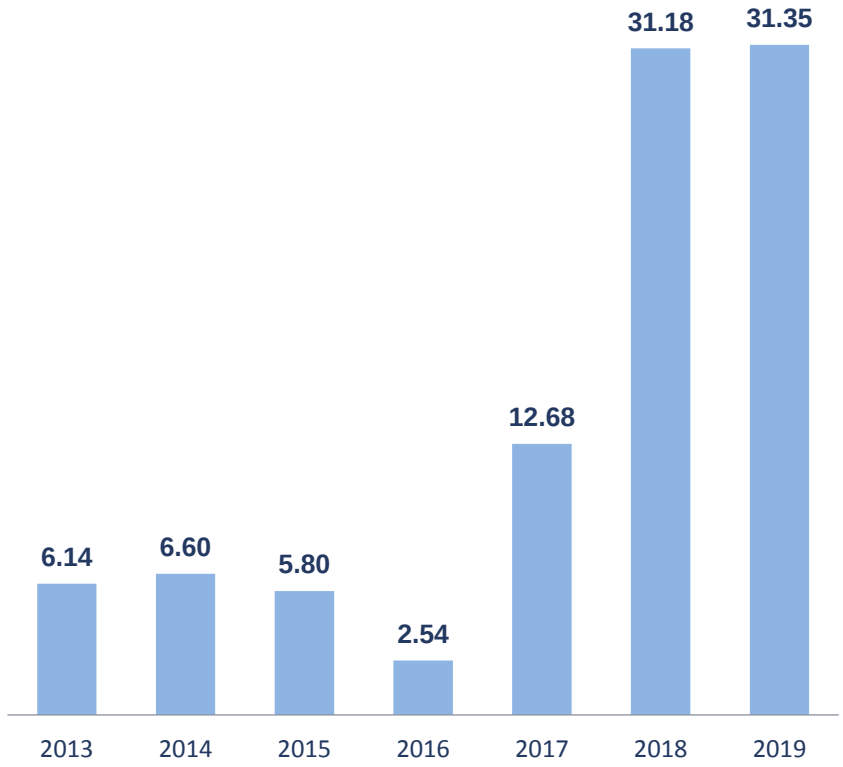
EBITDA

(NT$mn)



EPS

(NT$)



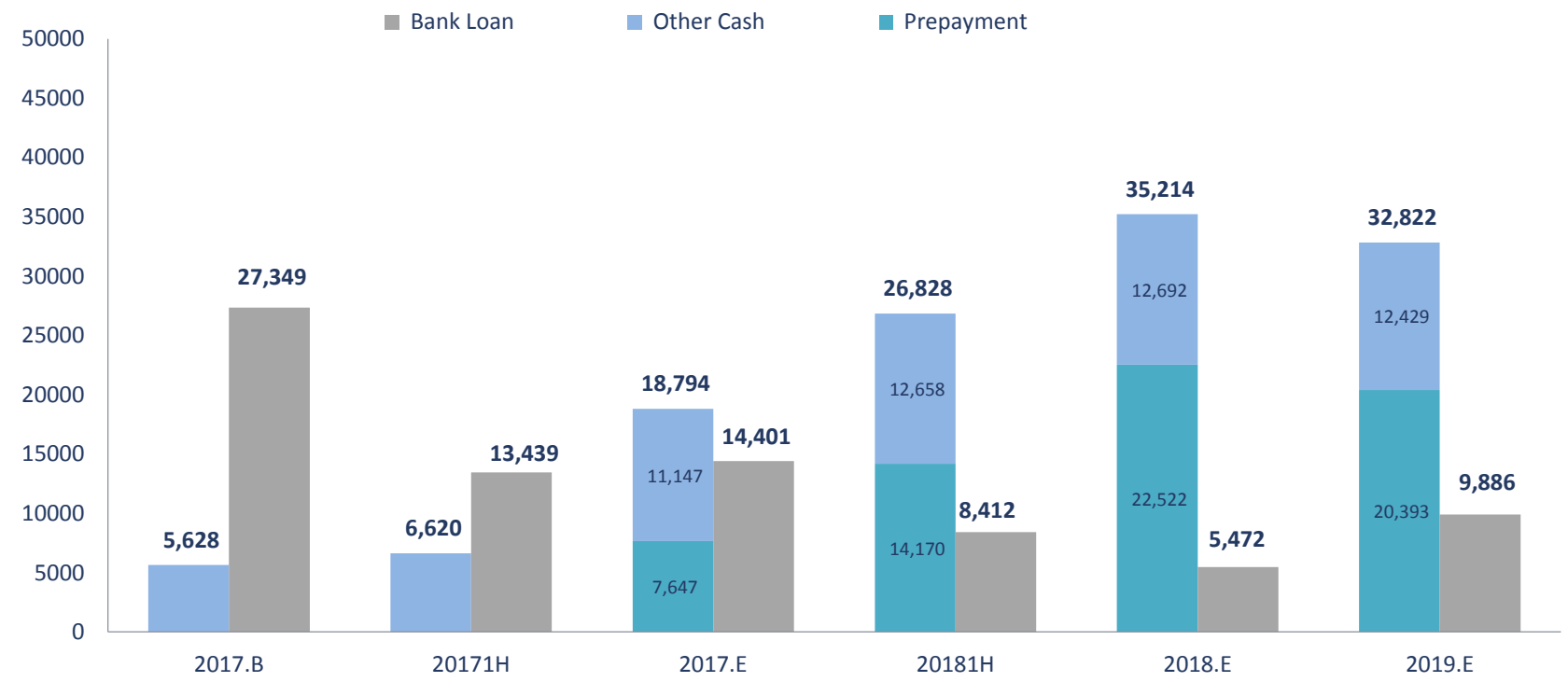
© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved

財務比率

- 投資前瞻技術的資本支出略微降低現金總額，但仍維持高水位。
- 股利配發拉高銀行貸款。

現金部位&銀行借款

(NT$mn)

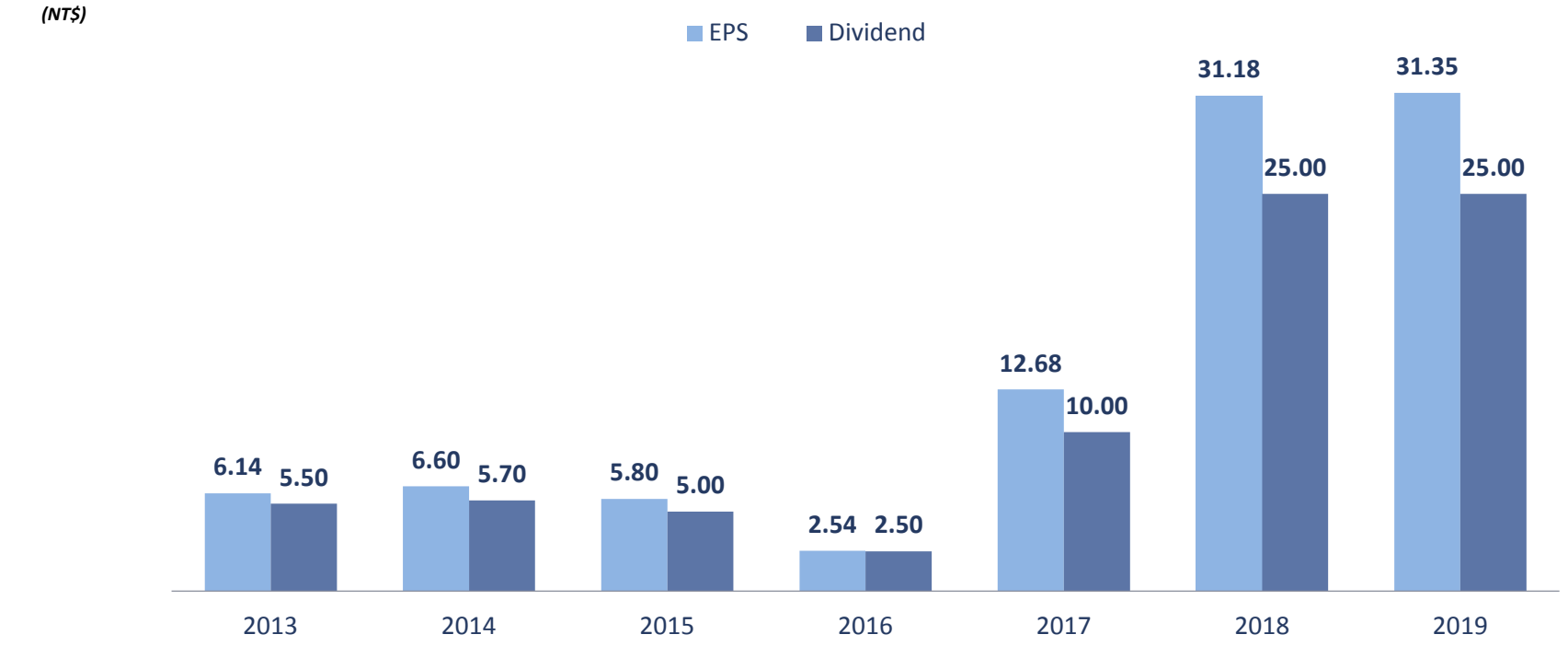


© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved

股利配發

- 豐厚的EPS結合高股利配發政策，可為股東帶來豐潤獲利。

每股股利配發與EPS



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
配發率	89.6%	86.4%	86.2%	98.4%	78.9%	80.2%	79.7%

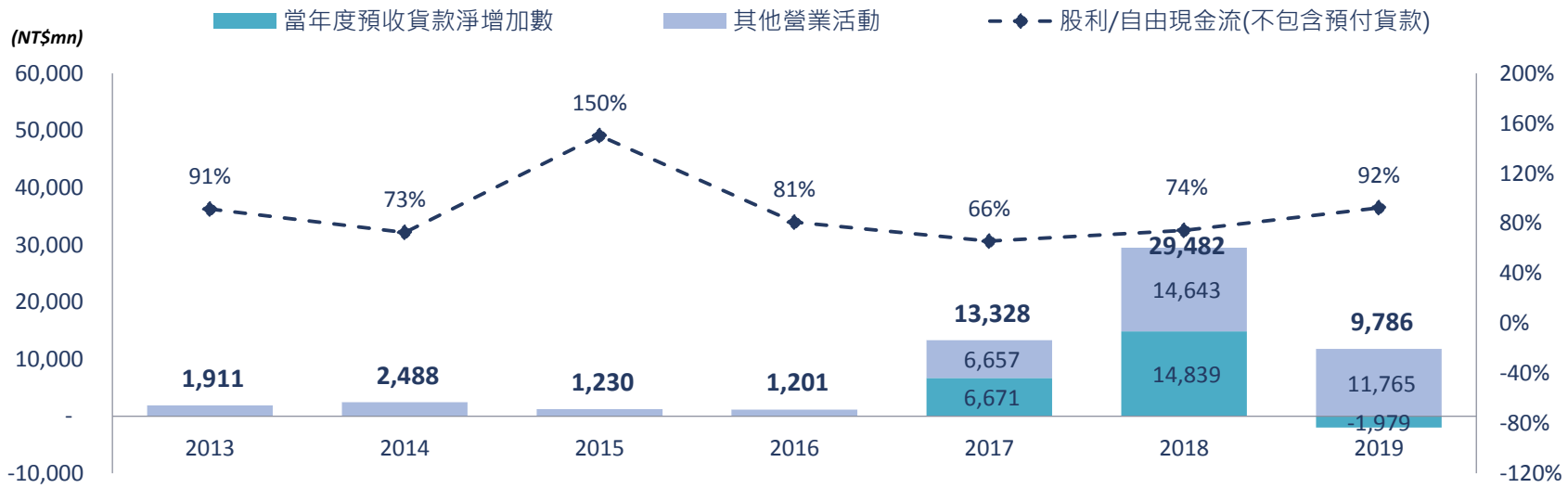
** 2019年股利配發待2020年6月23日股東會常會決議。*

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved

多次股利分配

- 每半年派發股息將有助於股東的資金活用與投資活動，協助股東創造更大的投資價值。
- 穩健的股利配發政策顯示環球晶圓信守經營成果回饋予股東的承諾，可望為股東帶來實質的投資效益。
- 股利配發時程：
  - 2020上半年股利 → 2021第1季配發
  - 2020下半年股利 → 2021第3季配發

股利配發 vs. 自由現金流*



備註:
*1. * 2019年股利配發待2020年6月23日股東會常會決議。*
2.自由現金流量=營業活動淨現金流入 - 資本支出
3. 2019預付貨款較低主因為2019年部分長約已出貨。

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved

綜合損益表

綜合損益表

(NT$百萬)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
營業收入	**15,570**	**15,922**	**15,310**	**18,427**	**46,213**	**59,064**	**58,094**
成長率 (%)	-	*2.3%*	*-3.8%*	*20.4%*	*150.8%*	*27.8%*	*-1.6%*
營業毛利	**3,663**	**3,728**	**4,073**	**4,130**	**11,808**	**22,299**	**22,847**
毛利率 (%)	*23.5%*	*23.4%*	*26.6%*	*22.4%*	*25.6%*	*37.8%*	*39.3%*
EBITDA	**4,053**	**4,087**	**4,046**	**3,025**	**12,221**	**22,712**	**22,648**
EBITDA (%)	*26.0%*	*25.7%*	*26.4%*	*16.4%*	*26.4%*	*38.5%*	*39.0%*
營業淨利	**2,194**	**2,336**	**2,685**	**1,378**	**7,414**	**17,578**	**17,897**
營業收入 (%)	*14.1%*	*14.7%*	*17.5%*	*7.5%*	*16.0%*	*29.8%*	*30.8%*
稅前淨利	**2,204**	**2,679**	**2,808**	**1,344**	**6,875**	**18,253**	**18,554**
稅前收入 (%)	*14.2%*	*16.8%*	*18.3%*	*7.3%*	*14.9%*	*30.9%*	*31.9%*
淨利	**1,948**	**2,095**	**2,044**	**939**	**5,278**	**13,634**	**13,636**
淨利 (%)	*12.5%*	*13.2%*	*13.4%*	*5.1%*	*11.4%*	*23.1%*	*23.5%*
每股盈餘 (NT$)	**6.14**	**6.60**	**5.80**	**2.54**	**12.68**	**31.18**	**31.35**

Note: 2016年GWC完成SunEdison半導體(SEMI)的收購後，2016年度之財務報告即包含SEMI，其涵蓋的期間為2016年12月2日至2016年12月31日。

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved

資產負債表

資產負債表

(NT$百萬)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
資產							
現金及約當現金	1,536	2,685	3,662	5,628	18,794	35,214	32,822
應收帳款	3,165	3,694	4,538	7,642	7,869	9,226	8,140
存貨	3,291	2,829	3,262	7,307	7,347	7,040	6,849
不動產、廠房及設備	9,796	8,972	9,361	31,036	28,202	30,887	34,697
其他資產	3,286	3,204	2,994	8,948	8,020	7,455	14,078
資產總計	**21,074**	**21,385**	**23,816**	**60,560**	**70,232**	**89,822**	**96,586**
負債							
短期借款	1,302	2,069	696	12,982	10,738	5,042	9,886
應付帳款	1,816	1,789	1,383	5,126	4,269	4,870	3,837
長期借款	--	--	--	14,367	3,663	430	0
其他負債	4,821	4,325	5,012	12,267	17,508	36,324	37,790
負債總計	**7,939**	**8,184**	**7,091**	**44,742**	**36,178**	**46,666**	**51,513**
權益總計	**13,135**	**13,201**	**16,725**	**15,819**	**34,054**	**43,156**	**45,073**

Note:
1.2016年GWC完成SunEdison Semiconductor (SEMI)的收購後，2016年度之財務報告即包含SEMI，其涵蓋的期間為2016年12月2日至2016年12月31日。
2.應收帳款包括關係人。
3.應付帳款包含關係人。

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved

Q&A

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved

Thank You

© GlobalWafers Co., Ltd. All rights reserved